

البينة التركيبية والخواص الإلكتروضوئية لبلورة ابيتاكسي أحادية من Cu(ln_{1-x}Ga_x)Se₂ ومركبات عيوب مرتبة

Structure and optoelectronic properties of single crystal epitaxial Cu(ln_{1-x}Ga_x)Se₂ and ordered defect compounds

A. Rockett, G. Berry, D. Schroeder, H.-Z. Xiao, and L. Chung Yang

الخلاصة

نمت $cu(\ln_{1-x}Ga_x)Se_2$ بشكل ابيتاكسي (نمو بلوري مطابق للشبكة البلورية لأرضية الترسيب) على نمت $cu(\ln_{1-x}Ga_x)Se_2$ (111) بين درجتي حرارة 50° C ألى 50° C مع $1 \ge x \ge 0$. نسبة $cu(\ln+Ga]$ بين v, v. v. $cu/[\ln+Ga]$ بين $0 \le x \le 735^\circ$ مع $1 \ge x \ge 0$. نسبة $cu(\ln+Ga]$ بين y=0.3 (111) بين درجتي حرارة 50° C ألى 50° C ألى y=0.3 مع y=0.3 المرتبة كانت متجانسة في كل الطبقات (120 يا ي 20.3 العنية بالمجموعة III لكل محتويات Ga. الأفلام التي نمت ب0.3 = 2.5 بينا محتويات طاقة تساوي الابيتاكسي الغنية بالمجموعة III لكل محتويات Ga. الأفلام التي نمت ب0.3 = 2.5 بيناك فجوات طاقة تساوي 120 vev (120 يا ي 20.3 بالمحتويات 120 التي نمت ب0.3 = 2.5 معناك فجوات طاقة تساوي 120 vev الابيتاكسي الغنية بالمجموعة III لكل محتويات Ga. الأفلام التي نمت ب0.3 = 2.5 بعرب التكدس الابيتاكسي الغنية بالمجموعة III لكل محتويات معن المائوني المحتوي لذيل الحزم. عيوب التكدس vev (120 بعلي على كلا من على كلا من تلألؤ الكاثود والامتصاص الضوئي لذيل الحزم. عيوب التكدس تؤثر على كلا من معدل النمو والتلألؤ ولكن يمكن ان يتحول إلى اضطرابات في موضعه (dislocations) بالمعالجة الحرارية السريعة. اعلى قيمة لقابلية حركة الفجوات حتى الآن 200 cm²/v-sec وتزداد عند درجات حرارة منخفضة. تركيز الفجوات أعطى دليل على مستوى 80 meV فوق حافة حزمة التكافؤ عند درجات حرارة منخفضة. تركيز الفجوات أعطى دليل على مستوى 80 meV فوق حافة حزمة التكافؤ عند تركيز يزيد عن 10^{10} cm³ cm³ vert النوع عند 100 K فوق عاد المستوى 40 meV



المقدمة

واحدة من المشاكل الحرجة التي تواجه الخلايا الشمسية المعتمدة على CulnSe₂ هو قلة الفهم الأساسي ل-CuInSe₂ والسبانك ذات العلاقة (بالأخص سبانك Ga)، وطبقات العيوب المرتبة والذي يعتقد انه من التمييز في محتويات المجموعة III لسطح طبقات CuInSe₂ المتعددة التبلور. هذا العمل مكمل لجهود سابقة لتحسين فهم خصائص طبقات الابيتاكسي الأحادية التبلور لـ Cu(In_{x-1}Ga_x)Se₂ على أرضيات GaAs. تصف ورقة علمية خواص وتطبيقات فيلم CuInSe2 الرقيق في أجهزة الفوتوفولتيك يمكن ان تجدها في المرجع المرجع علمية خواص وتطبيقات فيلم CuInSe2 الرقيق في أجهزة الفوتوفولتيك يمكن ان تجدها في المرجع ورقة علمية نواص وتطبيقات فيلم CuInSe2 الرقيق في أجهزة المعتمدة على CuInSe2 والمركبات ذات العلاقة يمكن ان نجدها في المرجع [2] والمرجع [3]. الهدف الأساسي لهذه الورقة العلمية هو دراسة تأثير عيوب سطحية وخطية ونقطية في Se₂ المرجع الارامي على الخواص الضوئية والإكثرونية لأشباه الموصلات.

التجربة العملية



إلى تغيرات في محتوى Ga يعتمد على درجة حرارة الترسيب. تيار الانتزاع لهدف Cu أو Cu-Ga يتراوح (0.10 و A 0.30 عند جهد يتراوح بين V 500-440 على التوالي. لهدف In كان التيار والجهد -0.10 م بين 0.10 عند V 0.30، عند جهد يتراوح بين V 0.0-440 على التوالي. لهدف In كان التيار والجهد -0.10 م 0.10 عند V 0.10 عند V 0.30 على التوالي، وتم ضبطه بدقة للحصول على النسبة الكيميائية المطلوبة. درجة حرارة Se/(Cu+ln+Ga) عند Se/(Cu+ln+Ga) معدل على نسبة فيض 5 < [(Cu+ln+Ga)]. معدل الترسيب كان 10 إلى 100 من خلال التحكم بتيار الانتزاع للـ Cu

نظام تلألؤ الكاثود المستخدم في هذه الدراسة هو ميكروسكوب الكتروني ماسح SEM) Ziss) واستخدم كاشف Ge مع تبريد بالهيليوم السائل في مرحلة القياسات عند درجات حرارة منخفضة. (X 24.3 K). قياسات الامتصاص الضوئي والنفاذ والانعكاس أجريت عند درجة حرارة الغرفة باستخدام مقياس الطيف بالشعاع المزدوج Lambda Perkin Elmer. مورفولوجي السطح والتركيب تمت دراستها باستخدام SEM من النوع Hitachi S-800 مزود بنظام قياس طيف تشتت طاقة أشعة اكس EDS. عينات قياسية بتركيب معروف استخدمت لإيجاد كمي لبيانات EDS لتركيب الأفلام. واستخدمت في حالات عدم توفر العينات القياسية استخدمت تصحيحات عددية ZAP. شكل التركيب الكيميائي تم الحصول عليه بواسطة مقياس طيف الكتلة ذو الأيونات الثانوية (SIMS) من instrument Cameca IMS 5f. در اسات التركيب المايكروي (تحليل صور حيود الإلكترونات في المجال المضيء والمجال المعتم) أجريت بواسطة الميكروسكوب الإلكتروني النافذ TEM من النوع Philips EM420 and CM12. در اسات TEM عالية الدقة التحليلية أجريت باستخدام TEM من النوع Hitachi 9000 يعمل عند kV. عينات مقطعية من منظور مستوي وعرضي تم تحضير ها لـ TEM بواسطة علمية ترقيق ميكانيكية لسمك mm 80-80 ثم تعرضت لشعاع أيوني لتثقيبها عند K 77 في مرحلة التبريد باستخدام أيونات +Ar عند KK. أجريت قياسات تأثير هول في حجرة تفريغ يمكن تبريدها بثلاجة دائرة مغلقة لدرجة حرارة K 15 K-. تم قياس درجة الحرارة باستخدام ثير موستر مثبت على جانب العينة ويمكن التحكم به حتى toc± باستخدام سخان صغير. المجال المغناطيسي كان Tesla . نقاط التوصيل كانت من In أو Au او Pb. مقياس التيار ومصدر التيار يتم التحكم بهما بو اسطة الكميبو تر المستقبل للبيانات و تحليلها



طبقات ابيتاكسي من بلورة أحادية من $Cu(In_{x-1}Ga_x)Se_2$ مع 1.0~, 0.3, ~0.6, 1 مع نسبة (001) مع 1.0~, v، v.0.4~, v, Cu/(ln+Ga) و0.5 (001) مع 1.0 مع 0.2 و 2.2 ≥ 0.5 م ترسيبها على GaAs (001) وGaAs مع المارك (111) وGaAs مع درجات حرارة من 500 إلى $2^{\circ}Sc_2$ وبمعدل يتراوح بين mm/min (111) Ga_{As} (111) معد درجات حرارة من 550 إلى $2^{\circ}Sc_2$ وبمعدل يتراوح بين (111) معد درجات حرارة من 2.5 إلى $2^{\circ}Sc_2$ وبمعدل يتراوح بين (111) معد درجات حرارة من 2.5 إلى $2^{\circ}Sc_2$ وبمعدل يتراوح بين (111) معد درجات حرارة من 2.5 إلى $2^{\circ}Sc_2$ وبمعدل يتراوح بين (111) معد درجات حرارة من 2.5 إلى $2^{\circ}Sc_2$ وبمعدل يتراوح بين (111) معد درجات حرارة من 2.5 إلى $2^{\circ}Sc_2$ وبمعدل يتراوح بين (111) معد 2.5 إلى $2^{\circ}Sc_2$ والمال بين 2.5 إلى $2^{\circ}Sc_2$ والمالم بين 2.5 معلي دليل على مشاركة طور (112) و Sc_2 والمالم بن (112) معلى مخطط الطور الثلاثي-besudo. الماسية والتركيب و عيوب السطح كانت متشابه لتلك القريبة من النسبة الكيميائية (stoichiometry) لية النمو الأساسية والتركيب و عيوب السطح كانت متشابه لتلك القريبة من النسبة الكيميائية (stoichiometry) لية النمو الأساسية والتركيب و عيوب السطح كانت متشابه المالي القريبة من النسبة الكيميائية (stoichiometry) له والتركيب و عيوب السطح على اسطح ناعمة عند القريبة من النسبة الكيميائية (300) له وstoichiometry) المشار له سابقا [6-4]. ظهرت تعرجات على السطح مع ميل نحو السطح الأمامي لتشكل اسطح $3^{\circ}Sc_2$ (112) بالرغم من الحصول على اسطح ناعمة عند درجات ترسيب عالية على Sac (112) أخراء صغيرة من السطح على عينات غنية بالح و وعينات المحمو مع ميل نحو السطح الأمامي لتشكل اسطح $3^{\circ}Sc_2$ (112) بالرغم من الحصول على اسطح ناعمة عند درجات ترسيب عالية على Sac (100). أجزاء صغيرة من السطح على عينات غنية بالح وعينات درجات حروب المحمو مع ميل نحو السطح على عمارة المحمور وحينات درجات ترسيب عالي قامه مع المامي المامي المحمور وحينات درجات ترسيب عالي مالح مع ميل نحو السطح الامامي المحمور ور منائية الشكل وجدت عاليا على اسطح الاحمام وعينات درجات تشوه لسطحها على اسطح أذار مالمالي وجدت غالبا على اسطح أفلام غنية بالمحمو مالمالي مالم مالي وجدت غالبا على المحمور والالمحمويم مالمو مالم مالم ولالمحمو المالم مالي المحموم مالم مالم

الأفلام المحتوية على Ga قليل أو حتى بدون وجود Ga عن قصد وجدت ان كلها تحتوي على Ga بالقرب من السطح الفاصل نتيجة لانتشار الـ Ga من أرضية الترسيب. انتشار هذا الـ Ga في باقي الفيلم ازداد مع زيادة درجة حرارة الترسيب. فراغ متزامن للانتشار الداخلي يؤدي بصفة عامة إلى تشكيل فراغات Kirkendall ذات الاتجاه (112) عند الفاصل وتمتد في GaAs. عند درجات حرارة عالية مع عدم إضافة Ga بشكل متعمد إلى الأفلام الانتشار الخارجي كان قوي جدا أدى إلى وجود محتوى عالي مت من من المناف من المحتوية على وراغات الاتجاه (112) عند الفاصل وتمتد في GaAs. عند درجات حرارة عالية مع عدم إضافة Ga بشكل متعمد إلى الأفلام الانتشار الخارجي كان قوي جدا أدى إلى وجود محتوى عالي متجانس من Ga في العينات. حدوث انفصال إلى طبقات رقيقة من الأرضيات يعتبر امر شائع في هذه الحالة بسبب اندماج في العينات. حدوث انفصال إلى طبقات رقيقة من الأرضيات يعتبر امر شائع في هذه الحالة بسبب اندماج فراغات الانتشار المناف ال

البلورات الأحادية الغنية بمجموعة III أعطت دليل على حدوث عيوب مرتبة (كما تم تحديدها من نماذج حيود الإلكترونات في TEM). ليس مثل أفلام البلورات المتعددة، بينت الطبقات الابيتاكسي عدم وجود انفصالات سطحية لطبقة العيوب المرتبة. العيوب المرتبة تتغير في التركيز من عينة لعينة ولكنها متجانسة على كل العينة. عينة ولكنها متلكت فجوة طاقة متزايدة (No eV) بالمقارنة مع CulnSe مع كثافة فجوة طاقة فرعية على قد على من الطاقات.



الشكل 1 يوضح طيف تلألؤ الكاثود لعينة Culn₃Se₅. امتصاص الفجوة الفرعية والتلألؤ تناقص مع الميل لـ 80 meV (من قياسات الأمتصاص عند درجة حرارة الغرفة) إلى 80 meV (من قياسات تلألؤ الكاثود عند درجة حرارة لغرفة).



الشكل 1. طيف تلألؤ الكاثود لـ (CuIn₃Se₅ (a) و(b) من منطقة السطح المسطح ومن الجزر الهرمية على طيف تلألؤ الكاثود لـ (11)_{AS} GaAs وراث العينيتين نمتا على 111)_{AS} GaAs. كلا العينيتين نمتا على 111)_{AS} GaAs



نتائج الحيود مع التركيب والمقاومة النوعية العالية للعينات تقترح وجود عيوب تعويضية مرتبة على اسطح (001)، ومن المحتمل In على Cu في مواقع عيوب antisite وفراغات Cu. بينما العيوب مرتبة على المستويات (001)، ومن المحتمل العيوب مرتبة داخل هذه المستويات. عدم الترتيب داخل المستويات يجب ان يعطي زيادة في التغير ات الموضعية في كثافة العيوب. وهذا يسبب تغير ات موضعية في فجوة الطاقة بسبب مدى حالات الفجوة الفرعية. تفاصيل كاملة لخصائص 2013م

تحليل TEM مقطعي يبين وجود خلل في التكدس وتوائم مايكروية (microtwins) في كل الأفلام. كثافة عيوب التكدس كانت اعلى لأفلام بمحتوى Ga عالية ولكن من الممكن ان تكون بسبب الحساسية الأعلى لطبقات محتوى Ga العالية عند تحضير اسطح GaAs قبل ترسيب الفيلم وشروط الترسيب.

صور مقطع عرضي في الظلام لوحظت عيوب التكدس بجوار السطح للطبقات المجاورة ولكن ليس تحت المجزر (انظر الشكل 2). ظاهريا، عند حدوث عيوب التكدس خلال النمو قطبية السطح من الممكن ان تنعكس (أي يتغير السطح من معدن إلى Se أو بالعكس) ومعدل النمو للبلورة يتناقص فجأة. في المنطقة المحيطة حيث هناك لا يوجد فشل في عيوب فان النمو يستمر ويعطي جزء ذات شكل مثلث. قياسات تلألؤ الكاثود تبين زيادة في التلألؤ من الجزر (انظر الشكل 1) ولكن تغير طفيف في شكل منحى الطيف. هذا يعني ان التلألؤ ومتوسط عمر حاملات الألؤ من الجزر (انظر الشكل 1) ولكن تغير طفيف في شكل منحى الطيف. هذا يعني ان التلألؤ ومتوسط عمر حاملات الأكثرية تقمع بواسطة عيوب التكدس اسفل السطح مباشرة. حيث توجد جزر يوجد ومتوسط عمر حاملات الأكثرية تقمع بواسطة عيوب التكدس اسفل السطح مباشرة. حيث توجد جزر يوجد حجم كبير بجوار السطح خالي من العيوب ويعطي تلألؤ قوي. في اخر الأمر يحدث عيب اخر ويستعيد النمو بسرعة. عيوب التكدس عادة عدة مستويات من 6 (12) ذات تباعد واسع مع مسافات متكررة متوافقة مع وحدة خلية عيوب التكدس عادة عدة مستويات من 6 (12) ذات تباعد واسع مع مسافات متكررة متوافقة مع وحدة خلية قوحة قلية خالي السطح عليفات متكارة متوافقة مع وحدة خلية حدة خلية عليه التكدس عادة عدة مستويات من 6 (12) ذات تباعد واسع مع مسافات متكررة متوافقة مع وحدة خلية حدة خلية عدة مستويات من 6 (12) ذات تباعد واسع مع مسافات متكررة متوافقة مع وحدة خلية علية التكدس عادة عدة مستويات من 6 (12) ذات تباعد واسع مع مسافات متكررة متوافقة مع وحدة خلية وحدة خلية علية من العيوب ويعلي المالية من العادية من 6 (12) ذات تباعد واسع مع مسافات متكررة متوافقة مع وحدة خلية علية مسرعة.





الشكل 2. مقطع عرضي لصور TEM في المجال المعتم لعينة CuIn_{0.7}Ga_{0.3}Se₂. المناطق المضيئة هي عيوب التكديس

قياسات تأثير هو على النسبة الكيميائية (stoichiometric) وأفلام الابيتاكسي الغنية قليلا بالمجموعة III ترسبت على أرضيات GaAs شبه عازلة بينت ان الأفلام من النوع q مع تركيز حاملات شحنة 10 Cr- وقابلية حركة GaAs شبه عازلة بينت ان الأفلام من النوع q مع تركيز حاملات شحنة 10 Cr- وقابلية حركة GaAs في مع تركيز حاملات شحنة 10 Cr- وقابلية حركة GaAs في مع تركيز حاملات شحنة 10 Cr- وقابلية حركة Cm-2/V-sec عند درجة حرارة 20 Cr- أفلام غنية ب 20 Cr- وذات تناسق كيميائي (1 ≤ y) تمتلك مقاومة نوعية Cn- 10 Cr- في حين ان الأفلام الغنية بمجموعة III كانت مقاومتها النوعية 11 Cr- 10 Cr- 20 Cr- 2



(اقل من factor of 2 تغير) وجد على نطاق واسع من العينات بتراكيب في مدى التناسب الكيميائي إلى الغنية قليلا بمجموعة III ولـ x-0.3 (انظر الشكلين 3 و4).



الشكل 3. اعتماد تركيز الفجوات على درجة الحرارة لطبقتين ابيتاكسي من Culn_{1-x}Ga_xSe₂ بـ Culn



الشكل 4. نتائج قابلية الحركة لثلاثة طبقات ابيتاكسي من النوع p عند 0.3×



لدرجات حرارة مرتفعة (K) 150 K)، كل العينات يغلبها مستوى عيوب عند 80 meV فوق حافة حزمة التكافؤ عند تركيز يزيد على ³-10¹⁷ cm⁻³ لعينة التي لها اعلى قيمة y (قريبة جدا من التناسب الكيميائي (stoichiometry)) أظهرت وجود حالة عيوب ثانية عند 40 meV بالنسبة لحافة حزمة التكافؤ وبتركيز (stoichiometry)) أظهرت وجود حالة عيوب ثانية عند 10¹⁷ cm⁻³ فرى النسبة لحافة حزمة التكافؤ وبتركيز (stoichiometry)) أظهرت وجود حالة عيوب ثانية عند 40 meV بالنسبة لحافة حزمة التكافؤ وبتركيز (stoichiometry)) أظهرت وجود حالة عيوب ثانية عند 10¹⁷ cm⁻³ فرى منها قريب من 10^{15} cm⁻³ cm⁻³ النظر الشكل 3). لم تظهر أي عينات أخرى هذه الحالة ولكن لم يكن منها قريب من التناسب الكيميائي. غياب تحول النوع والمستقبل الضعيف في هذه العينة متوافق مع التغير من النوع n إلى عيوب الأقلية النوع p المصاحب للتغير في التناسب الكيميائي. تركيز الفجوة عند أي تحول للنوع يقترح ان تركيز عيوب الأقلية من النوع n كا¹⁵ cm⁻³ دركيز الفجوة عند أي تحول للنوع يقترح ان تركيز عيوب الأقلية من النوع n كان ²⁵ cm⁻³ من التوع يقترح ان تركيز عيوب الأقلية من النوع n كان ²⁵ cm⁻³ دركيز الفجوة عند أي تحول للنوع يقترح ان تركيز عيوب الأقلية من النوع n كان ²⁵ cm⁻³ دا¹⁰. المقاومة النوعية العالية للعينات الغنية بالمجموعة III تشير إلى البعد الكبير عن التناسب الكيميائي ويزداد تركيز العيوب المانحة وهذا في النهاية تعوض لعيوب تشير إلى البعد الكبير عن التناسب الكيميائي ويزداد تركيز العيوب المانحة وهذا في النهاية تعوض لعيوب النوع p عند 90 هذا يشر إلى البورات المتعدة و النوع n كان النوع n كان ويزداد تركيز العيوب المانحة وهذا في النهاية تعوض لعيوب النوع p على الجانب الغني بمحموعة III التناسب الكيميائي بصفة عامة والذي وجد في البورات المتعددة.

للعينات القريبة كثيرا من التناسب الكيميائي غياب تحول النوع سمح بالقياسات لحركية لدرجات حرارة اقل من 20 K. منحنيات الحركية تتبع سلوك أشباه الموصلات الكلاسيكي، زيادة وتناقص درجة الحرارة عند تناقص تشتت الشوائب المتأينة، وتمر عبر قمية عظمى وتتناقص بعد ذلك عندما يصبح تشتت الشوائب المتعادلة اكثر تأثيرا.

الاستنتاج

نمو ابيتاكسي لـ Culn_{1-x}Ga_xSe₂ لا يوجد دليل على فروقات جو هرية عامة ضوئية أو الكترونية أو مورفولوجية بخلاف التغيرات في فجوة الطاقة في Culn_{1-x}Ga_xSe₂ جو هرية عامة ضوئية أو الكترونية أو مورفولوجية بخلاف التغيرات في فجوة الطاقة في Culn_{1-x}Ga_xSe₂ كدالة في x. تشير النتائج إلى حدوث عيب نقطي مرتب في العينات الغنية بالمجموعة III على المستويات (100). العيوب تعطي ارتفاع في فجوات الطاقة المتزايدة وحالات ذيل الحزمة ادنى من فجوة الطاقة. فشل التكديس يتسبب في تقليل كبير لمعدل النمو على الاتجاهات (112) ونقصان في شدة تلألؤ الكاثود، من المحتمل بواسطة إعادة الاتحاد الغير مشع للحاملات. تشير الحركية العالية جدا للفجوة إلى ان طبقات الايبتاكسي ذات جودة عالية. تراكيز الحاملات المتشابهة تشير إلى وجود مستويات عيوب عند 80 meV تقريبا و 40 meV موجود في كل العينات في كل العينات في موجود في كل العينات في



حين ان الأخير (40meV) موجود فقط في عينة واحدة بتركيب قريب جدا من النسبة الكيميائية (stoichiometry). العينات المحتوية على تركيب عناصر من المجموعة III تبين تحويل إلى النوع n بعد التبريد. التغير في تركيز الفجوة عند حدوث هذا التحويل يقترح اعتماد على التركيب لمستوى تطعيم النوع n.

تمت الترجمة في المركز العلمي للترجمة

10-12-2011

www.trgma.com